# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-35592 (P2000 - 35592A)

(43)公開日 平成12年2月2日(2000.2.2)

| (51) Int.Cl.7 |        | 識別記号 | FΙ      |        |      | テーマコード(参考) |
|---------------|--------|------|---------|--------|------|------------|
| G02F          | 1/136  | 500  | G 0 2 F | 1/136  | 500  | 2H092      |
|               | 1/1345 |      |         | 1/1345 |      |            |
| H01L          | 29/786 |      | H01L    | 29/78  | 612C |            |

### 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 9 頁)

| (21)出願番号 | 特顧平10-204626          | (71)出顧人 | 595059056            |
|----------|-----------------------|---------|----------------------|
|          |                       |         | 株式会社アドバンスト・ディスプレイ    |
| (22)出願日  | 平成10年7月21日(1998.7.21) |         | 熊本県菊池郡西合志町御代志997番地   |
|          |                       | (72)発明者 | 野海 茂昭                |
|          |                       |         | 熊本県菊池郡西合志町御代志997番地 株 |
|          |                       |         | 式会社アドバンスト・ディスプレイ内    |
|          |                       | (74)代理人 | 100073759            |
|          |                       |         | 弁理士 大岩 増雄            |
|          |                       |         |                      |
|          |                       |         |                      |
|          |                       |         |                      |

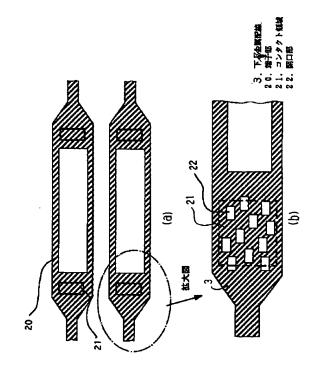
# 最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 液晶表示装置

## (57)【要約】

【課題】 走査配線 (ゲートバスライン) を比抵抗が小 さい材料を用いて構成すると共に、TFTアレイ基板の 端子部における比抵抗が小さい材料を用いて形成された 下層金属配線の後工程で用いられる薬液による腐食を防 止して、信頼性の高いかつ高開口率の液晶表示装置を得

【解決手段】 TFTアレイ基板の端子部20のコンタ クト領域21となる部分の下層金属配線3に複数個の矩 形状の開口部22をランダムに形成する。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明絶縁性基板と、

上記透明絶縁性基板にマトリクス状に配列されたスイッ チング素子、このスイッチング素子と電気的に接続され た画素電極、およびこの画素電極の周りに形成された走 査配線(ゲートバスライン)及び信号配線(ソースバス ライン)からなる表示部と、

上記透明絶縁性基板上の上記表示部の周辺部に下層金属 配線と、この下層金属配線と絶縁膜を介して形成された 上層金属配線がコンタクトホールを介して接続するコン 10 タクト領域を含む端子部とを有する第一の基板、

上記第一の基板と共に液晶材料を挟持する第二の基板を

上記端子部のコンタクト領域となる部分の上記下層金属 配線には、複数個の開口部が形成されていることを特徴 とする液晶表示装置。

【請求項2】 端子部のコンタクト領域となる部分の下 層金属配線に形成された複数個の開口部は、ランダムに 配置されていることを特徴とする請求項1記載の液晶表 示装置。

【請求項3】 端子部のコンタクト領域となる部分の下 層金属配線に形成された複数個の開口部は、上記端子部 を断線させる方向と交差する方向に数列に配列されてい ることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項4】 端子部のコンタクト領域となる部分の下 層金属配線に形成された複数個の開口部は、上記コンタ クト領域の長さより長い長さを有するスリット形状であ り、上記端子部を断線させる方向と交差する方向に配列 されていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装 置。

【請求項5】 端子部の下層金属配線は、AlまたはA 1を主成分とする合金により形成されていることを特徴 とする請求項1~4のいずれか一項記載の液晶表示装

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、液晶表示装置に 関し、特に薄膜トランジスタ(以下、TFTと称する) をスイッチング素子として搭載したアクティブマトリク ス型の液晶表示装置に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】図7は従来の低抵抗信号配線を有したT FT型液晶表示装置のTFTを搭載したTFTアレイ基 板のTFT部および端子部の製造工程を示す断面図であ る。図において、1はガラス基板等の透明絶縁性基板、 2は透明絶縁性基板1上に形成されたA1またはA1合 金等の低抵抗金属からなるゲート電極、3はゲート電極 2から延長して形成された下層金属配線、4は下層金属 配線3上の端子取り出し領域を保護するために形成され たレジストパターン、5および6はゲート電極2および 50 ーニングし、画素電極10を形成する。次に、図7

下層金属配線3の表面に形成された陽極酸化膜で、下層 金属配線3上のレジストパターン4が形成された領域に は陽極酸化膜6は形成されない。7は陽極酸化膜5、6 が形成されたゲート電極2および下層金属配線3上の全 面に形成されたシリコン窒化膜からなるゲート絶縁膜、 8はゲート絶縁膜7を介してゲート電極2上に形成され たアモルファスシリコン膜からなる半導体層、9は半導 体層 8 上に形成された n 型アモルファスシリコン膜か らなるコンタクト層、10はITO膜からなる画素電 極、11は下層金属配線3上のゲート絶縁膜7に形成さ れた端子取り出し用のコンタクトホール、12はコンタ クト層9上に形成されたソース・ドレイン電極、13は ソース・ドレイン電極12形成と同時に形成された端子 取り出し配線、14はコンタクト層9を選択的にエッチ ングして形成されたチャネル部、15は上記構成要素を 覆うように形成されたパッシベーション膜である。

【0003】図8は、図7に示す従来のTFT型液晶表 示装置のTFTアレイ基板を示す概略平面図、図9は図 8の端子部を拡大した平面図、図10、図11は図9の 20 端子部の製造工程を示す平面図である。図において、1 6はTFTおよび画素電極がマトリクス状に配列形成さ れた表示部、17はゲート端子、18はソース端子、1 9は陽極酸化用ショートパターン、20はゲート端子1 7またはソース端子18を拡大して示した端子部、21 は端子部20に形成されたコンタクト領域で、図7にお けるゲート絶縁膜7に形成された端子取り出し用のコン タクトホール11を介しての下層金属配線3と端子取り 出し配線13とのコンタクト部分である。

【0004】次に、従来のTFTを搭載したTFTアレ 30 イ基板の製造方法を図7、図10および図11に沿って 説明する。まず、図7(a)に示すように、透明絶縁性 基板1上にAlまたはAl合金等の比抵抗が小さい金属 による単層膜を成膜した後、レジストを用いてパターニ ングし、ゲート電極2および下層金属配線3を形成す る。次に、図7(b) および図10(a) に示すよう に、下層金属配線3上の端子取り出し領域を保護するた めにレジストパターン4を形成後、レジストパターン4 に覆われていない部分のゲート電極2および下層金属配 線3の表面層を選択的に陽極酸化処理して、陽極酸化膜 40 5、6を形成する。次に、レジストパターン4を除去 後、プラズマCVD法によりゲート絶縁膜7となるシリ コン窒化膜、アモルファスシリコン膜、n<sup>\*</sup>型アモルフ ァスシリコン膜を順次成膜した後、レジストを用いてア モルファスシリコン膜および n 型アモルファスシリコ ン膜をパターニングし、ゲート電極2の上方にTFT部 の半導体層8およびコンタクト層9を形成する(図7 (c)、図10(b))。

【0005】次に、図7(d)および図10(c)に示 すように、ITOを成膜した後、レジストを用いてパタ

(3)

(e) および図10(d) に示すように、端子取り出し 領域のゲート絶縁膜7をエッチングして端子取り出し用 のコンタクトホール11を形成する。次に、図7 (f) および図11(a)に示すように、Cr等を成膜した 後、レジストを用いてパターニングし、ソース・ドレイ ン電極12および端子取り出し配線13を形成する。こ のとき、端子取り出し配線13はコンタクトホール11 を介して下層金属配線3と電気的に接続される。続け て、ドライエッチング法によりソース・ドレイン電極1 2に覆われていない部分のn<sup>・</sup>型アモルファスシリコン 10 膜(コンタクト層9)をエッチングしてチャネル部14 を形成する。最後に、図7(g)および図11(b)に 示すように、TFT部を保護するためにシリコン窒化膜 等からなるパッシベーション膜15を形成する。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】以上のように、従来の TFT型液晶表示装置のTFTアレイ基板においては、 走査配線(ゲートバスライン)を微細化して高開口率の 液晶表示装置を得るために、比抵抗が小さいAlを主成 分とする材料を用いて形成した低抵抗信号配線を有して 20 いるが、低抵抗信号配線を構成するAIまたはAI合金 は耐薬品性に乏しく、また、画素電極10形成時(図7 (d) および図10(c)) には、端子部20のコンタ クト領域21の下層金属配線3はゲート絶縁膜7に覆わ れているだけなので、このゲート絶縁膜7にピンホール 等の膜欠損部が存在した場合、画素電極10を構成する ITO膜のパターニングに用いられるエッチング液が、 ゲート絶縁膜7の膜欠損部を通して浸透し、図12に示 すように、端子部20のコンタクト領域21のA1また はAl合金からなる下層金属配線3に腐食領域23を形 成し、下層金属配線3を断線させたり、下層金属配線3 と端子取り出し配線13とのコンタクトを阻害するなど の問題があった。

【0007】この発明は、上記のような問題点を解消す るためになされたもので、走査配線(ゲートバスライ ン) を比抵抗が小さい材料を用いて構成すると共に、T F Tアレイ基板の端子部における比抵抗が小さい材料を 用いて形成された下層金属配線の断線を防止して、信頼 性の高いかつ高開口率の液晶表示装置を得ることを目的 とする。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】この発明に係わる液晶表 示装置は、透明絶縁性基板と、透明絶縁性基板の中央部 にマトリクス状に配列されたスイッチング素子、このス イッチング素子と電気的に接続された画素電極およびこ の画素電極の周りに形成された走査配線(ゲートバスラ イン)及び信号配線(ソースバスライン)からなる表示 部と、透明絶縁性基板上の表示部の周辺部に下層金属配 線と、この下層金属配線と絶縁膜を介して形成された上 層金属配線がコンタクトホールを介して接続するコンタ 50 形成された表示部、17はゲート端子、18はソース端

クト領域を含む端子部とを有する第一の基板、および第 一の基板と共に液晶材料を挟持する第二の基板を備え、 端子部のコンタクト領域となる部分の下層金属配線に は、複数個の開口部が形成されているものである。

【0009】また、端子部のコンタクト領域となる部分 の下層金属配線に形成された複数個の開口部は、ランダ ムに配置されているものである。また、端子部のコンタ クト領域となる部分の下層金属配線に形成された複数個 の開口部は、端子部を断線させる方向と交差する方向に 数列に配列されているものである。また、端子部のコン タクト領域となる部分の下層金属配線に形成された複数 個の開口部は、コンタクト領域の長さより長い長さを有 するスリット形状であり、端子部を断線させる方向と交 差する方向に配列されているものである。また、端子部 の下層金属配線は、AlまたはAlを主成分とする合金 により形成されているものである。

#### [0010]

【発明の実施の形態】実施の形態1.以下、この発明の 一実施の形態である液晶表示装置を図に基づいて説明す る。図1は本発明の実施の形態1による液晶表示装置の TFTアレイ基板のTFT部および端子部の製造工程を 示す断面図である。図において、1はガラス基板等の透 明絶縁性基板、2は透明絶縁性基板1上に形成されたA 1またはA1合金等の低抵抗金属からなるゲート電極、 3はゲート電極2から延長して形成された下層金属配 線、4は下層金属配線3上の端子取り出し領域を保護す るために形成されたレジストパターン、5および6はゲ ート電極2および下層金属配線3の表面に形成された陽 極酸化膜で、下層金属配線3上のレジストパターン4が 形成された領域には陽極酸化膜6は形成されない。7は 陽極酸化膜5、6が形成されたゲート電極2および下層 金属配線3上の全面に形成されたシリコン窒化膜からな るゲート絶縁膜、8はゲート絶縁膜7を介してゲート電 極2の上方に形成されたアモルファスシリコン膜等から なる半導体層、9は半導体層8上に形成されたn・型ア モルファスシリコン膜からなるコンタクト層、10は1 TO膜からなる画素電極、11は下層金属配線3上のゲ ート絶縁膜7に形成された端子取り出し用のコンタクト ホール、12はコンタクト層9上に形成されたソース・ ドレイン電極、13はソース・ドレイン電極12形成と 同時に形成された端子取り出し配線、14はコンタクト 層9を選択的にエッチングして形成されたチャネル部、 15は上記構成要素を覆うように形成されたパッシベー ション膜である。

【0011】図2は、図1に示す液晶表示装置のTFT アレイ基板の概略平面図、図3は図2の端子部を拡大し た図で、(a)は端子部の概略平面図、(b)は端子部 を構成する下層金属配線の拡大平面図である。図におい て、16はTFTおよび画素電極がマトリクス状に配列 子、19は陽極酸化用ショートパターン、20はゲート端子17またはソース端子18を拡大して示した端子部、21は端子部20に形成されたコンタクト領域で、図1におけるゲート絶縁膜7に形成された端子取り出し用のコンタクトホール11を介しての下層金属配線3と端子取り出し配線13とのコンタクト部分である。22は端子部20の下層金属配線3に形成された開口部である。

【0012】次に、本実施の形態による液晶表示装置の TFTアレイ基板の製造方法を説明する。まず、図1 (a) に示すように、透明絶縁性基板1の表面に例えば CuをO. 2重量%含有したA1(以下、A1-O. 2 wt%Cuと記載)膜のような比抵抗が小さい金属膜を スパッタ法等により約270nm成膜した後、写真製版 法により形成したレジストを用いてパターニングし、ゲ ート電極2および下層金属配線3を形成する。このと き、図3(b)に示すように、端子部20のコンタクト 領域21となる部分の下層金属配線3に複数個の矩形状 の開口部22をランダムに形成する。また、A1膜のエ ッチングには燐酸、酢酸および硝酸を主成分とするエッ チング液を用いるが、予め燐酸、酢酸および硝酸の組成 を検討して、AI膜のエッチング端面をテーパ形状に形 成することにより、上層に形成される膜の被覆性を向上 できる。

【0013】次に、下層金属配線3上の端子取り出し領域を保護するためにレジストパターン4を形成した後、ゲート電極2および下層金属配線3と電気的に短絡したショートパターン19を用い、レジストパターン4に覆われていない部分のゲート電極2および下層金属配線3の表面層を選択的に陽極酸化処理して陽極酸化膜5およ30び6を形成する(図1(b))。このとき、レジストパターン4に覆われている部分には陽極酸化膜は形成されないため、後工程において、端子取り出し領域の陽極酸化膜を除去する工程が不要となる。その後、レジストパターン4を除去する。

【0014】次に、プラズマCVD法によりゲート絶縁膜7となるシリコン窒化膜を約370nm、アモルファスシリコン膜を約120nm、不純物がドープされたn型アモルファスシリコン膜を約30nm順次成膜した後、写真製版法により形成したレジストを用いて、アモルファスシリコン膜およびn、型アモルファスシリコン膜を同時にパターニングし、ゲート電極2の上方にTFT部の半導体層8およびコンタクト層9を形成する(図1(c))。次に、図1(d)に示すように、透明導電膜としてITO膜をスパッタ法等により約100nm成膜した後、写真製版法により形成したレジストを用いてパターニングし、画素電極10を形成する。次に、図1(e)に示すように、端子取り出し領域のゲート絶縁膜7をドライエッチング法によりエッチングして、端子取り出し用のコンタクトホール11を形成する。50

【0015】次に、図1(f)に示すように、ソース・ ドレイン電板12およびソースバスライン(図示せず) を形成するために、まずスパッタ法等により、最下層に コンタクト層9を構成するn<sup>\*</sup>型アモルファスシリコン 膜および画素電極10を構成するITO膜とオーミック コンタクト性が良好な С г 膜を約100 nm、中間層に 比抵抗が小さいA1-0.2wt%Cu膜を約300n m、最上層にCr膜を約50nm連続して三層膜を形成 する。次に写真製版法により形成したレジストを用いて 10 三層膜を順次パターニングし、ソース・ドレイン電極1 2および端子取り出し配線13を形成する。このとき、 端子取り出し配線(上層金属配線)13は端子取り出し 用のコンタクトホール11を介して下層金属配線3と電 気的に接続される。続けて、ドライエッチング法により ソース・ドレイン電極12に覆われていない部分のn' 型アモルファスシリコン膜(コンタクト層9)をエッチ ングしてチャネル部14を形成する。

【0016】最後に、図1(g)に示すように、TFT 部を保護するために、プラズマCVD法等によりシリコン窒化膜を約500nm成膜し、パッシベーション膜15を形成する。以上の工程により形成されたTFTアレイ基板と、他の透明絶縁性基板上に遮光膜、対向電極等が形成された対向基板の表面に配向膜を形成後対向させ、この間に液晶材料を注入してシール材で封入することにより液晶表示装置を構成する。

【0017】本実施の形態による液晶表示装置のTFT アレイ基板においては、画素電極10形成時に、画素電 極10を構成する ITO膜のパターニングに用いられる エッチング液が、図4に示すように、端子部20のコン タクト領域21においてゲート絶縁膜7の膜欠損部を通 して浸透し、AIまたはAI合金からなる下層金属配線 3を腐食した場合においても、下層金属配線3に形成さ れた開口部22により腐食領域23が拡大するのを抑制 でき、下層金属配線3の断線を防止することができる。 【0018】この発明によれば、TFTアレイ基板の端 子部20のコンタクト領域21となる部分の下層金属配 線3に複数個の矩形状の開口部22をランダムに形成す ることにより、画素電極10を構成するITO膜のパタ ーニングに用いられるエッチング液が、ゲート絶縁膜7 の膜欠損部を通して浸透した場合でも、エッチング液に よる下層金属配線3の腐食領域23が拡大するのを抑制 でき、下層金属配線3の断線を防止できる。

【0019】実施の形態2.実施の形態1では、TFT アレイ基板の端子部20のコンタクト領域21となる部分の下層金属配線3に複数個の矩形状の開口部22をランダムに形成したが、図5(a)に示すように、下層金属配線3に形成される複数個の矩形状の開口部22を端子部20を断線させる方向と交差する方向に数列に配列することにより、画素電極10を構成するITO膜のパ50ターニングに用いられるエッチング液が、ゲート絶縁膜

7

7の膜欠損部を通して浸透した場合でも、図5(b)に 示すように、エッチング液による下層金属配線3の腐食 領域23をより小さい範囲内で留めることができる。

【0020】実施の形態3. 実施の形態2では、TFT アレイ基板の端子部20のコンタクト領域21となる部 分の下層金属配線3に複数個の矩形状の開口部22を端 子部20を断線させる方向と交差する方向に配列形成し たが、図6(a)に示すように、下層金属配線3に形成 する開口部をコンタクト領域21の長さより長い長さを を断線させる方向と交差する方向に配列することによ り、画素電極10を構成するITO膜のパターニングに 用いられるエッチング液が、ゲート絶縁膜7の膜欠損部 を通して浸透した場合でも、図6(b)に示すように、 エッチング液による下層金属配線3の腐食領域23を二 本のスリット状開口部24の間で留めることができる。 [0021]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、走査 配線(ゲートバスライン)を比抵抗が小さい材料を用い て構成すると共に、TFTアレイ基板の端子部のコンタ 20 子部を示す平面図である。 クト領域となる部分の下層金属配線に複数個の矩形状の 開口部を形成することにより、画素電極を構成するIT 〇膜のパターニングに用いられるエッチング液が、下層 金属配線を被覆する絶縁膜の膜欠損部を通して浸透した 場合に、エッチング液による下層金属配線の腐食領域が 拡大するのを抑制でき、下層金属配線の断線を防止し て、信頼性の高いかつ高開口率の液晶表示装置を得るこ とができる。また、TFTアレイ基板の端子部のコンタ クト領域となる部分の下層金属配線に形成される開口部 を、コンタクト領域の長さより長い長さを有する複数本 30 ゲート絶縁膜、8 半導体層、9 コンタクト層、10 のスリット状開口部とし、端子部を断線させる方向と交 差する方向に配列することにより、下層金属配線を被覆 する絶縁膜の膜欠損部を通して画素電極を構成するIT O膜に対するエッチング液が浸透した場合においても、 エッチング液による下層金属配線の腐食領域をより小さ い範囲内に留めることができる。

【図面の簡単な説明】

\*【図1】 この発明の実施の形態1による液晶表示装置 のTFTアレイ基板の製造工程を示す断面図である。

8

【図2】 この発明の実施の形態1による液晶表示装置 のTFTアレイ基板を示す概略平面図である。

【図3】 この発明の実施の形態1による液晶表示装置 のTFTアレイ基板の端子部を示す平面図である。

【図4】 この発明の実施の形態1による液晶表示装置 の効果を説明するための平面図である。

【図5】 この発明の実施の形態2による液晶表示装置 有する複数本のスリット状開口部24とし、端子部20 10 のTFTアレイ基板の端子部の構造および本実施の形態 による効果を説明するための平面図である。

> 【図6】 この発明の実施の形態3による液晶表示装置 のTFTアレイ基板の端子部の構造および本実施の形態 による効果を説明するための平面図である。

> 【図7】 従来のこの種液晶表示装置のTFTアレイ基 板の製造工程を示す断面図である。

> 【図8】 従来の液晶表示装置のTFTアレイ基板を示 す概略平面図である。

【図9】 従来の液晶表示装置のTFTアレイ基板の端

【図10】 従来の液晶表示装置のTFTアレイ基板の 端子部の製造工程を示す平面図である。

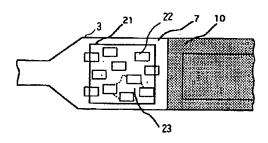
【図11】 従来の液晶表示装置のTFTアレイ基板の 端子部の製造工程を示す平面図である。

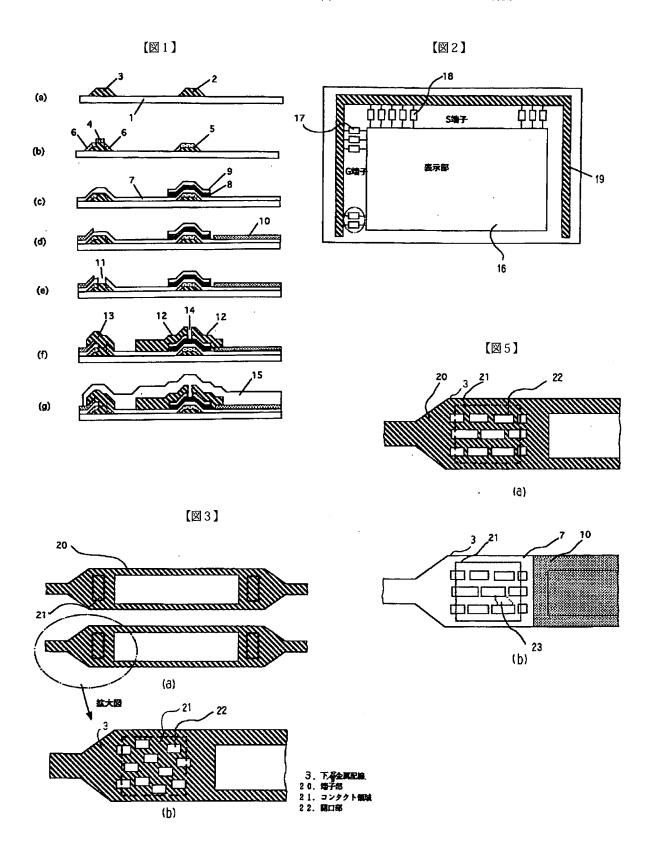
【図12】 従来の液晶表示装置における問題点を示す 平面図である。

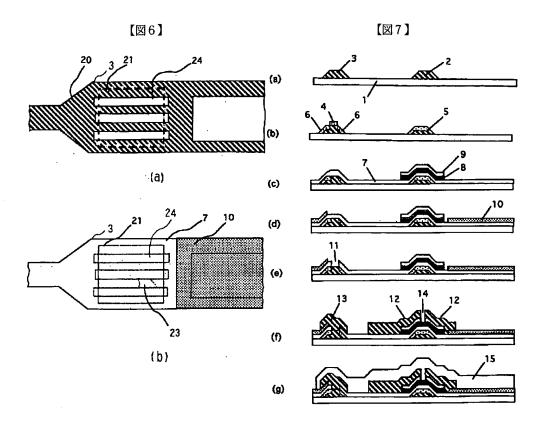
#### 【符号の説明】

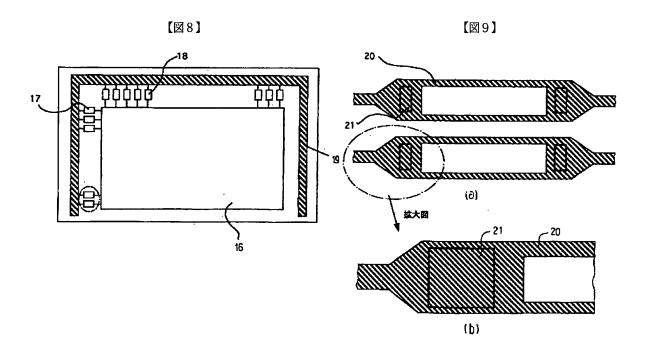
1 透明絶縁性基板、2 ゲート電極、3 下層金属配 線、4 レジストパターン、5、6 陽極酸化膜、7 画素電極、11 コンタクトホール、12 ソース・ ドレイン電極、13 端子取り出し配線、14 チャネ ル部、15 パッシベーション膜、16 表示部、17 ゲート端子、18 ソース端子、19 陽極酸化用シ ョートパターン、20 端子部、21 コンタクト領 域、22 矩形状開口部、23 腐食領域、24 スリ ット状開口部。

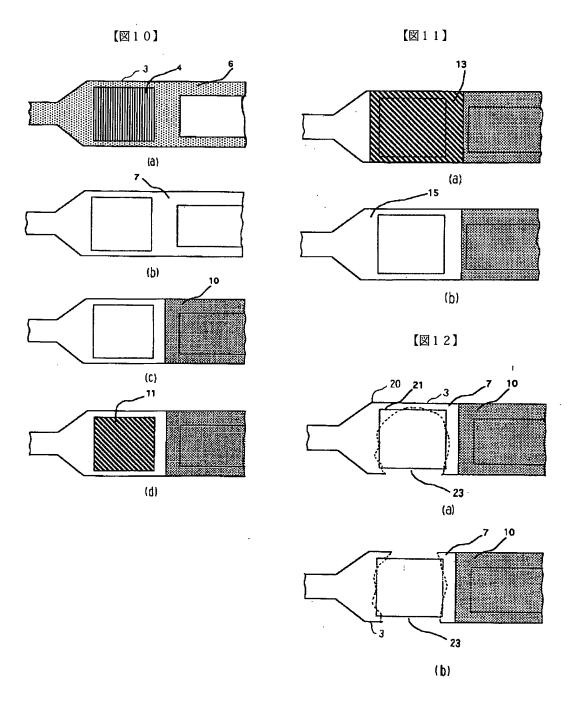
[図4]











# フロントページの続き

Fターム(参考) 2H092 JA26 JA29 JA33 JA35 JA38

JA39 JA42 JA43 JA44 JA47

JB13 JB23 JB27 JB32 JB33

JB36 JB38 JB54 JB56 JB63

JB69 JB79 KA05 KA07 KA12

KA16 KA18 KA22 KB05 KB14

KB23 KB24 MA05 MA08 MA14

MA15 MA16 MA18 MA19 MA20

MA24 MA27 MA34 MA35 MA37

MA41 NA14 NA15 NA25 NA27

NA28 NA29 PA06